NITTO KOGYO

ニュースリリース

2026年9月18日
日東工業株式会社

米国「OCP Global Summit 2026」に 次世代AIインフラを支える「OCP ORV3ラック」を展示

～村田製作所の電源ソリューション、三桜工業の冷却技術とともに展示～

日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長 手嶋晶隆、以下 日東工業）は、2026年10月12日（月）から10月15日（木）まで米国カリフォルニア州サンノゼで開催される「OCP Global Summit 2026」において、株式会社村田製作所（本社：京都府長岡京市、代表取締役社長 中島規巨、以下 村田製作所）のブースにて「OCP ORV3ラック」の展示を行います。

生成AIの急速な普及に伴い、データセンターのインフラにはより高い性能と効率性が求められています。「OCP Global Summit」は、次世代AIデータセンターの課題解決に向けた最新技術が集結する世界で最も重要なイベントの一つです。

本サミットでは、Open Compute Project（OCP）の最新仕様「OCP ORV3（Open Rack V3）」に準拠し、AIワークロードに代表される高密度・高発熱なIT機器の実装に最適化された、次世代データセンター向け「OCP ORV3ラック」に、三桜工業株式会社（登記社名：三櫻工業株式会社、本社：茨城県古河市、代表取締役社長 竹田玄哉）のマニホールド及び水冷配管アセンブリを実装し展示します。データセンター向け電源ソリューションのグローバルリーダーである村田製作所のブースにて展示することにより、両社の技術を結集した高効率で信頼性の高い統合ソリューションをご提案いたします。

「OCP Global Summit 2026」にご来場の際は、ぜひ村田製作所ブースにお立ち寄りいただき、日東工業の「OCP ORV3ラック」をご覧ください。

■「OCP Global Summit 2026」出展概要
・展示会名：OCP Global Summit 2026
・開催期間：2026年10月12日（月）～10月15日（木）
・会場：San Jose McEnery Convention Center
（米国カリフォルニア州サンノゼ）
・出展ブース：株式会社村田製作所ブース内（ブース番号：A15）
・公式ホームページ（英語）：
https://www.opencompute.org/summit/global-summit

■出展製品



OCP ORV3ラック

■OCP(Open Compute Project)とは
OCPは、Meta社（旧Facebook）が中心となって設立した非営利団体です。データセンターのハードウェア設計をオープンソース化することでイノベーションを促進し、効率的なデータセンターの構築を目的としたプロジェクトです。
日東工業はOCPに加盟し、その普及を推進しています。

OCP BRONZE™ Member

※OCP Bronzeマークおよびロゴは、Open Compute Project Foundationが所有しており、許可のもとに使用されています。

以上

お問合せ先：広報室 TEL:0561-64-0123

NITTO 日東工業株式会社